

HC33-32LF3(LX) HC40-32LF3(LX)
 HC33-32KLF3(KLX) HC40-32KLF3(KLX)

熱風加熱式 大気WAVE
 Hot air blow heating WAVE system



特長

- 完全鉛フリー対応
 FLIP式はんだ槽、高精度プリヒート。
- スポットクーラー標準装備!!
 最適なはんだ付を実現。
- 2次噴流ノズル外部調整機構
- タッチパネル集中制御
- プリント回路基板の予熱温度を自動調節。
- 局所N₂フードの搭載による酸化ドロスの低減

FEATURES

- Completely lead-free
 FLIP type solder bath, high precision preheat.
- Spot cooler is standard to be attached for optimum soldering!!
 Optimum soldering has been realized.
- Secondary nozzle former remote adjustable mechanism
 Remote control with Lap top PC. (Option)
- Central control with touch panel
- Automatic adjustment of preheating temperature of the printed circuit board.
- Reduce solder dross with local N₂ hood

仕様/SPECIFICATION

	HC33-32LX	HC40-32LX
対象基板 Applicable boards	MAX W330×L350×t1.6 (mm) MIN W 50×L120×t0.6 (mm)	MAX W400×L450×t1.6 (mm) MIN W 50×L120×t0.6 (mm)
部品高さ Component height	上面 Upper 150mm以下 下面 Lower 6mm以下	上面 Upper 150mm以下 下面 Lower 6mm以下
入力電源 Power source	AC200V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 97A	AC200V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 97A
搬送角度 Conveyor angle	4~5指定可能 (標準4.5°)	4~5指定可能 (標準4.5°)
装置寸法 Dimensions	W1320×L3200×H1630 (mm)	W1390×L3200×H1630 (mm)
装置質量 Weight	約 Approx. 1500kg	約 Approx. 1500kg
はんだ容量(Sn100%) Soldering capacity	約 Approx. 490kg	約 Approx. 490kg

